

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

ML8

Erstellt:

Wodke, Alexander

Kunde:

Datum:

06.09.2022



Prozesstechnik: B: Pinlamination C: Pinlamination

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		2
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	33	L2	3
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	124		4
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		5
A-RS-FR4-ML-0.10mm-035+035-TG150-HF	50200647	33	L3	6
		100		
		33	L4	
A-RS-FR4-ML-0.10mm-035+035-TG150-HF	50200641	110		7
		0		
A-RS-FR4-ML-0.10mm-035+035-TG150-HF	50200647	33	L5	9
		100		
		33	L6	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	124		10
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		11
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	33	L7	12
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		13
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	RS	14

B00: C00

Dicke nach Verpressen

B00: 720 µm

Tol+: 100 µm

Tol-: 100 µm

Dmax: 820 µm

Dmin: 620 µm

C00: 890 µm

Tol+: 100 µm

Tol-: 100 µm

Dmax: 990 µm

Dmin: 790 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+: 0 µm

Tol-: 0 µm

Dmax: 0 µm

Dmin: 0 µm

Kundenforderung

Dicke (D): 1000 µm

Tol+: 100 µm

Tol-: 100 µm

Dmax: 1100 µm

Dmin: 900 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal: 894 µm

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik